

半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工监理 资格审查情况报告

由广州广芯封装基板有限公司组织实施的半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工监理招标项目，已委托建成工程咨询股份有限公司（招标代理机构）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台组织进行公开招标，已通过资格后审方式完成资格审查程序。现将资格审查情况报告如下：

1、本项目于 2025 年 11 月 25 日 00 时 00 分至 2025 年 12 月 15 日 09 时 30 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布招标公告并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站公开接受投标登记，共有 4 家投标单位在规定的时间内投标登记成功，分别为：中铁十五局集团有限公司、广州万安建设监理有限公司、广东工程建设监理有限公司、公诚管理咨询有限公司。

在规定的时间内 3 家单位成功递交电子投标文件，分别为：广州万安建设监理有限公司、广东工程建设监理有限公司、公诚管理咨询有限公司。

2、本项目于 2025 年 12 月 15 日 09 时 30 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）增城交易部第 1 开标室进行公开开标，3 家投标单位成功解密投标文件及开标，结果详见《开标记录表》、《异议记录表》、《投标文件电脑机器特征码系统分析结论表》。

4、本项目评标委员会由 5 人组成，其中 1 人为业主评委，其余 4 名专家全部从广东省综合评标评审专家库相关专业中随机抽取。

评标委员会名单为：_____。

5、评标委员会一致推举_____为本项目评标委员会组长。

6、本项目于 2025 年 12 月 16 日 09 时 00 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）增城交易部第 2 评标室进行评标，评标委员会根据各投标单位提交的资格审查材料对照招标公告及招标文件规定的资格审查标准进行资格审查。结果如下：

7、经评审，3 家投标申请人均通过资格审查。（详见《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》）。

特此报告。

评标委员会签名：

2025 年 12 月 16 日